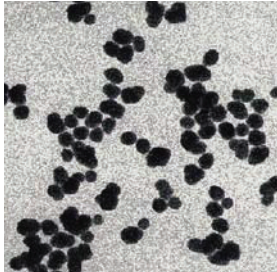
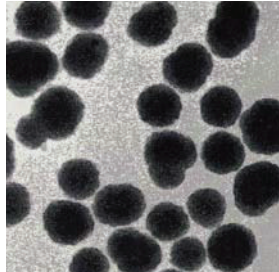


PLANERLITE

CMP



PLANERLITE-7101



PLANERLITE-4101



This photograph is an image.
Esta fotografia é uma imagem.

PLANERLITE

The PLANERLITE series of polishing slurries is intended for use in chemical mechanical planerization (CMP), a key planerization process in the fabrication of high-density ULSI devices. It has been developed under the basic concepts of high purity, high removal rate, high dispersion and scratchfree performance.

PLANERLITE-4000 series

This polishing slurry is designed for use on SiO₂ films (interlayer dielectric, STI). Based on ultra-high purity colloidal silica or fumed silica, it is available in several grades with varying additives and abrasive particle concentration, enabling users to select the product optimal for their specific process parameters and cost/performance requirements.

PLANERLITE-6000 series

This polishing slurry is designed for use with polysilicon. There is a variety of types available, either polishing slurry based on ultra-high purity colloidal silica or rinsing agent with special additives which keeps post-polishing wafer surface hydrophilic. The polishing slurry, in all types has extremely high polysilicon removal rate with excellent selectivity to silicon oxide film. The rinsing agent helps prevent particle adhesion, simplifying wafer cleaning process. The entire line can be used at high dilutions, and adjustment of the dilution provides control of removal rate and selectivity while also delivering high cost/performance. Abrasive particles are completely dispersed, eliminating sedimentation in a high stable slurry.

PLANERLITE

A série PLANERLITE de lamas de polimento destina-se à utilização em capacidade de planicidade mecânica-química (CMP), um processo de planicidade essencial no fabrico de dispositivos ULSI de alta densidade. Foi desenvolvida sob os conceitos básicos de alta pureza, alta taxa de remoção, alta dispersão e desempenho sem riscos.

Série PLANERLITE-4000

Esta lama de polimento foi concebida para utilização em películas de SiO₂ (dielétrico de camadas intermédias, STI). Com base na ultra alta pureza da sílica coloidal ou sílica pirogenada, encontra-se disponível em diversos graus com variados aditivos e concentração de partículas abrasivas, permitindo aos utilizadores seleccionar o produto ideal para os seus parâmetros de processo específico e requisitos de custo/desempenho.

Série PLANERLITE-6000

Esta lama de polimento foi concebida para utilização com polisilício. Existe uma variedade de tipos disponíveis tanto em lama de polimento com base em ultra alta pureza de sílica coloidal como de agentes de lavagem com aditivos especiais que mantêm hidrófila a superfície das pastilhas de sílica no pós-polimento. A lama de polimento, em todos os tipos, possui uma taxa extremamente elevada de remoção de polisilício, com excelente seletividade para a película de óxido de silício. O agente de lavagem ajuda a evitar a adesão de partículas, simplificando processo de limpeza das pastilhas de sílica. Toda a linha pode ser utilizada a altas diluições e o ajuste da diluição proporciona um controlo da taxa de remoção e seletividade enquanto oferece excelente relação custo/desempenho. As partículas abrasivas estão completamente dispersas, eliminando a sedimentação numa lama altamente estável.

■ PLANERLITE

PLANERLITE-7000 series

This polishing slurry is designed specifically for Cu metallization in the damascene process. Based on ultra high purity colloidal silica with special additives, it delivers high copper removal rate, with excellent selectivity to barrier metal. As a result, erosion is low and residual copper on the barrier metal is minimal, making it possible to completely stable, with no sedimentation, and minimal scratching. We also offer a high-dilution type, contributing to lower cost for copper damascene process.

PLANERLITE-8000 series

This polishing slurry is designed for barrier metal in the Cu interconnection. Based on ultra purity colloidal silica with special additives, it delivers enough barrier metal removal rate with planarity to be kept by designed selectivity. Also it delivers minimal scratch and minimal roughness, as ideal polishing slurry.

■ PLANERLITE

Série PLANERLITE-7000

Esta lama de polimento foi especificamente concebida para metalização do cobre no processo damasceno. Baseada na sílica coloidal de ultra alta pureza com aditivos especiais, proporciona alta taxa de remoção de cobre, com excelente seletividade ao metal de barreira. Como resultado, a erosão é baixa e o cobre residual no metal de barreira é mínimo, tornando possível estabilizar completamente, sem sedimentação, e riscos mínimos. Nós também oferecemos um tipo de alta diluição, contribuindo para reduzir o custo do processo damasceno do cobre.

Série PLANERLITE- 8000

Esta lama de polimento foi concebida para metal de barreira em interligação com cobre. Baseada na sílica coloidal de ultra alta pureza com aditivos especiais, proporciona uma taxa de remoção da barreira ao metal suficiente com planicidade a ser mantida pela seletividade projetada. Além disso, oferece possibilidade de riscos e rugosidade mínimas, como lama de polimento ideal.